

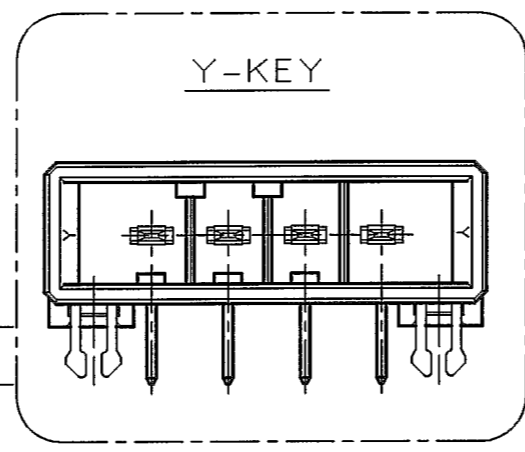
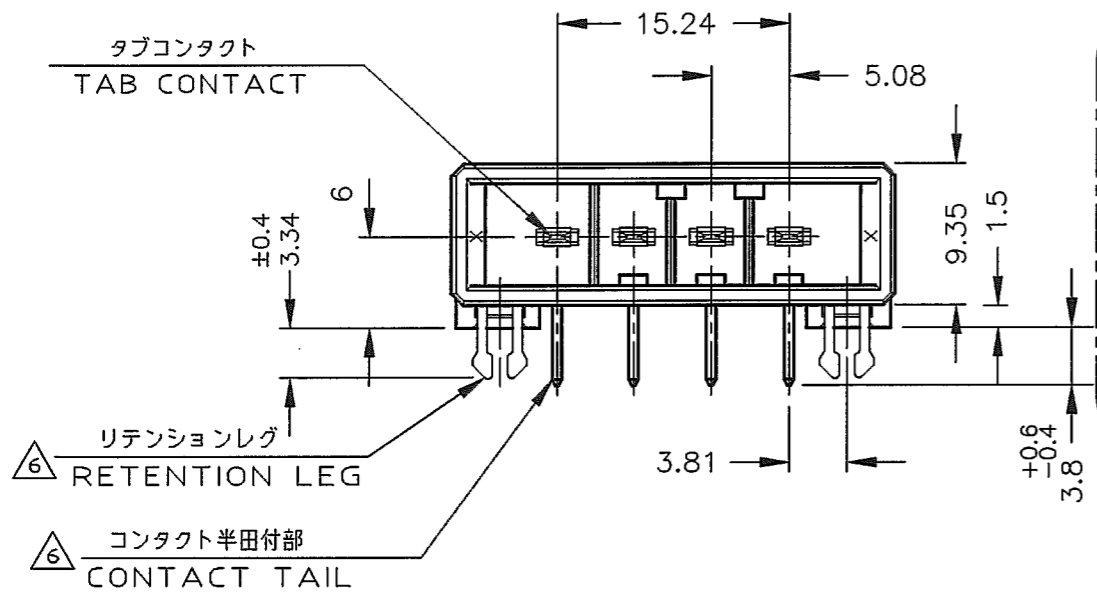
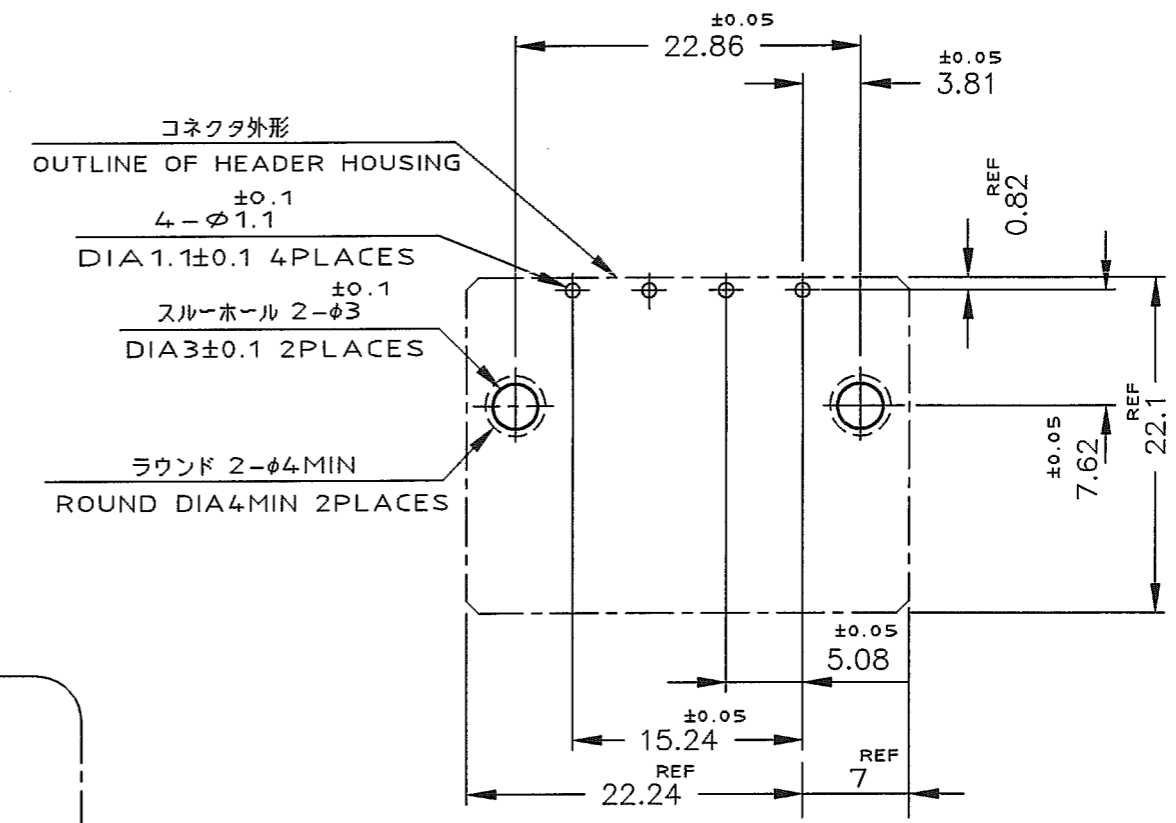
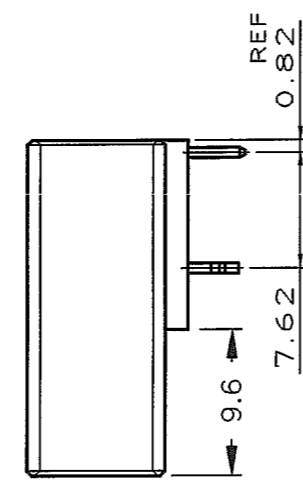
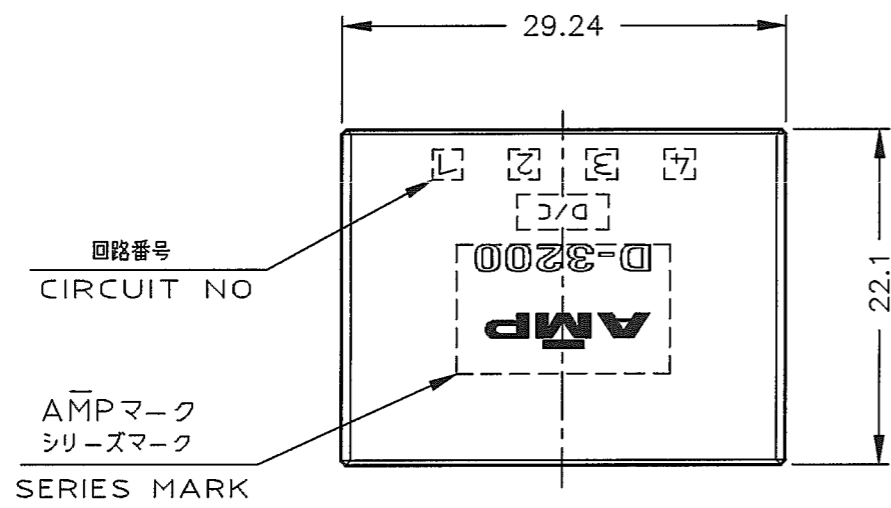
NUMBER 179277



METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST



推奨基板取付け穴寸法
PC 基板厚: 1.6±0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILED THERMO PLASTIC, POLYESTER
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- △2. FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- △3. FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- △4. FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- △5. FINISH (RETENTION LEG): TIN LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- △6. FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
- △2. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38 μm MIN金めっき
- △3. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76 μm MIN金めっき
- △4. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MINスズめっき
- △5. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の土に半田めっき
- △6. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部: ニッケル下地の土にスズめっき

△6	△4	2-179277-5	Y
△6	△3	2-179277-3	Y
△6	△2	2-179277-2	Y
△6	△4	1-179277-5	X
△6	△3	1-179277-3	X
△6	△2	1-179277-2	X
(FINISH)	製品番号 (PART NO.)	KEY	

D1	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	23MAR11
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE

WIRE RANGE		INSULATION DIA	NAME	
mm ² (AWG -)		mmφ	4 POS SINGLE ROW HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC D-3200	
MATERIAL SEE NOTE 注記参照		FINISH SEE NOTE 注記参照		
DR. 10 DEC 93 N. Matsubara		DE. 10 DEC 93 N. Matsubara		
CHK. 13 DEC 93 S. MANABE		APP. 13 DEC 93 S. MANABE		
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		SIZE	LOC	NUMBER
10mm以下: ±0.3 10mm超30mm以下: ±0.4 30mm超100mm以下: ±0.5 角 度: ±3'		A3	J	C=179277
SCALE		REV.		SHEET
2-1		D1		1 OF 1

